

- (a) either the manufacturer alone or the manufacturer in concert with the user of the integrated circuit originated the design or program;
- (b) the program is unalterably fixed at the time of manufacture; and
- (c) the manufacturer establishes that the design, basic functions and performance of the integrated circuit are only for the intended end-use.

(3) Assemblies of electronic components, modules, printed circuit boards with mounted components, substrates and integrated circuits, including packages therefor, as follows:

- (a) substrates for printed circuits, including ceramic and coated metal substrates, single-sided, double-sided or multilayer, and thin copper foils therefor, other than

- (i) printed circuit boards that are manufactured from

- (A) paper-base phenolics,
- (B) glass-cloth melamine,
- (C) glass epoxy resin, uncoated or coated with copper foil of a thickness of 18  $\mu\text{m}$  or greater,

- (D) polyethylene terephthalate, or

- (E) any other insulating material that has

- (I) a maximum continuous rated operating temperature not above 150°C,
- (II) a dissipation factor equal to or greater than 0.009 at 1 MHz,
- (III) a relative dielectric constant equal to or less than 8 at 1 MHz, and
- (IV) a coefficient of expansion equal to or greater than  $\pm 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$  over a temperature range of 0°C to 120°C,

- (ii) ceramic substrates that have not more than two layers of interconnections, including the ground plane, or

- (iii) copper foil that has a thickness of 18  $\mu\text{m}$  or greater;

- (b) ceramic packages for integrated circuits that are designed for hermetically sealed pin or pad grid-array, leadless carrier or surface-mounted configurations, other than those that

- (i) are of a single-in-line, dual-in-line or flat-pack configuration,

- (ii) have pin, pad or lead spacings of 2.5 mm or more, and

- (iii) have 40 leads or fewer;

- (c) assemblies, modules and printed circuit boards with mounted components that contain

- (i) substrates for printed circuit boards that are included in paragraph (a), or

- (ii) components that are included in this List, other than

- (A) those in which the only components included in this List are capacitors,

- (B) power-supply assemblies,

- (C) non-coherent light-emitting alphanumeric displays that incorporate monolithic integrated circuits and that

- a) leur conception ou leurs programmes sont effectués par leur fabricant seul ou en collaboration avec leur utilisateur;
- b) ils ont des programmes emmagasinés de façon inaltérable au moment de leur fabrication;
- c) leur fabricant établit que leur conception, leurs fonctions de base et leurs performances répondent uniquement à l'utilisation finale prévue.

(3) Ensembles de composants électroniques, modules, plaques de circuits imprimés avec composants incorporés, substrats et circuits intégrés, y compris leurs boîtiers, à savoir:

- a) substrats pour plaques de circuits imprimés, notamment substrats céramiques et de métal revêtu, simple face, double face ou multicouches, et feuilles de cuivre minces pour ces substrats, à l'exclusion:

- (i) des plaques de circuits imprimés fabriquées à partir de l'un des matériaux ci-après:

- (A) papier bakéliné,

- (B) tissu de verre mélamine,

- (C) tissu de verre à base de résine époxyde non revêtu ou revêtu d'une feuille de cuivre d'une épaisseur d'au moins 18  $\mu\text{m}$ ,

- (D) téréphtalate de polyéthylène,

- (E) tout autre matériau isolant qui a, à la fois:

- (I) une température maximale nominale d'utilisation permanente d'au plus 150 °C,

- (II) un facteur de dissipation à 1 MHz d'au moins 0,009,

- (III) une constante diélectrique relative à 1 MHz d'au plus 8,

- (IV) un coefficient d'expansion d'au moins  $\pm 10^{-5}$  par °C (degré centigrade) dans une gamme de températures de 0 °C à 120 °C,

- (ii) des substrats céramiques ne comportant pas plus de deux couches d'interconnexions, y compris le plan de masse,

- (iii) des feuilles de cuivre d'une épaisseur d'au moins 18  $\mu\text{m}$ ;

- b) boîtiers céramiques de circuits intégrés conçus pour des configurations à réseau en grille de broches ou de plots, à support sans sortie ou à montage de surface, hermétiquement scellés, à l'exclusion de ceux qui ont à la fois:

- (i) une configuration à sorties sur une ligne, sur deux lignes ou en boîtier plat,

- (ii) un espacement des broches, des plots ou des fils d'au moins 2,5 mm,

- (iii) une composition d'au plus 40 fils;

- c) ensembles, modules et plaques de circuits imprimés avec composants incorporés qui:

- (i) soit comportent des substrats de plaques de circuits imprimés inclus dans l'alinéa a),

- (ii) soit contiennent des composants inclus dans la présente liste, à l'exclusion de ce qui suit:

- (A) ensembles, modules et plaques de circuits imprimés dont les seuls composants inclus dans la présente liste sont des condensateurs,

- (B) ensembles d'alimentation,

- (C) visuels alphanumériques émettant de la lumière non cohérente et comprenant des circuits intégrés monolithiques qui à la fois: